

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2022-025

中国振华（集团）科技股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告



二〇二二年四月

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”、“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做优做强公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟申请非公开发行 A 股股票。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中含义相同）：

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 251,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	半导体功率器件产能提升项目	79,000.00	79,000.00
2	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	72,000.00	72,000.00
3	新型阻容元件生产线建设项目	14,000.00	14,000.00
4	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	38,000.00	38,000.00
5	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	28,800.00	28,800.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		251,800.00	251,800.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）半导体功率器件产能提升项目

1. 项目概况

项目名称	半导体功率器件产能提升项目
项目实施主体	振华永光
建设周期	36 个月

建设地点	贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区
项目建设内容	对现有厂房和租用厂房进行适应性改造。 振华永光现有 4 英寸线已经无法满足产能需要，振华永光拟建设一条 12 万片/年产能的 6 英寸硅基/碳化硅基功率器件制造线；将陶瓷封装、金属封装两条生产线的烧结、压焊工序整合，采用自动化设备进行生产，新增产能 400 万只/年；并针对现有的塑封生产线进行拓展，新增产能 2,600 万只/年。
项目主要产品	6 英寸功率半导体、陶瓷封装功率半导体器件、金属封装功率半导体器件和塑料封装功率半导体器件等。
项目投资总额	79,000.00 万元
募集资金投入金额	79,000.00 万元

2. 项目投资概算

本项目投资总计 79,000.00 万元，投资明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	占投资比例 (%)	拟投入募集资金
1	建筑工程费	4,715.00	5.97	4,715.00
2	设备购置及安装费	64,500.00	81.65	64,500.00
3	工程建设其他费用	1,003.06	1.27	1,003.06
4	预备费	2,457.63	3.11	2,457.63
5	铺底流动资金	6,324.31	8.01	6,324.31
合计		79,000.00	100.00	79,000.00

3. 项目经济效益评价

本项目的税后内部收益率为 19.34%，税后投资回收期为 6.60 年(含建设期)。

4. 项目用地、立项和环评等事项

本项目计划使用振华永光现有厂房并租用振华科技厂房进行生产建设，建设地点为贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区，不涉及新增土地。截至本次非公开发行股票预案公告日，本项目已完成项目备案，环评批复程序尚在办理中。

(二) 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目

1. 项目概况

项目名称	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目
------	--------------------

项目实施主体	振华微
建设周期	36个月
建设地点	广东省东莞市虎门镇中国电子东莞产业园
项目建设内容	租用厂房并进行适应性改造。 购置自动生产系统、自动化、高精度设备仪器等，最终建成柔性智能制造工艺制造平台，并提升薄膜工艺制造平台产能和检测试验平台的检测能力。 形成厚膜混合集成电路产能17万只/年、微电路模块产能35万只/年、薄膜器件及电路10万只（片）/年以及SIP系统级封装等，形成检测能力120万只/年。
项目主要产品	厚膜混合集成电路、微电路模块、薄膜器件及电路以及SIP系统级封装等，形成检测能力120万只/年。
项目投资总额	72,000.00万元
募集资金投入金额	72,000.00万元

2. 项目投资概算

本项目投资总计72,000.00万元，投资明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	占投资比例（%）	拟投入募集资金
1	建筑工程费	4,715.00	6.55	4,715.00
2	设备购置及安装费	58,849.50	81.74	58,849.50
3	工程建设其他费用	984.44	1.37	984.44
4	预备费	1,936.47	2.69	1,936.47
5	铺底流动资金	5,514.59	7.66	5,514.59
合计		72,000.00	100.00	72,000.00

3. 项目经济效益评价

本项目的税后内部收益率为20.57%，税后投资回收期为6.76年（含建设期）。

4. 项目用地、立项和环评等事项

本项目计划租用振华科技全资子公司东莞市中电桑达科技有限公司厂房进行生产建设，建设地点为广东省东莞市虎门镇中国电子东莞产业园，项目建设不涉及新增土地。截至本次非公开发行股票预案公告日，本项目备案、环评等相关手续尚未办理完毕，公司将尽快根据要求履行完毕相关程序。

(三) 新型阻容元件生产线建设项目

1. 项目概况

项目名称	新型阻容元件生产线建设项目
项目实施主体	振华云科
建设周期	24 个月
建设地点	贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区
项目建设内容	对生产厂房内进行适应性改造，包括新增工艺生产设备 137 台/套，对动力设施进行适应性改造。 形成芯片电容产能 7000 万只/年、衰减器产能 120 万只/年、芯片电阻产能 200 万只/年，采样电阻产能 55 万只/年，射频功率电阻产能 12 万只/年。
项目主要产品	芯片电容、衰减器、芯片电阻、采样电阻和射频功率电阻等。
项目投资总额	14,000.00 万元
募集资金投入金额	14,000.00 万元

2. 项目投资概算

本项目投资总计 14,000.00 万元，投资明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	占投资比例 (%)	拟投入募集资金
1	建筑工程费	1,340.00	9.57	1,340.00
2	设备购置及安装费	11,572.00	82.66	11,572.00
3	工程建设其他费用	237.66	1.70	237.66
4	预备费	394.49	2.82	394.49
5	铺底流动资金	455.85	3.26	455.85
	合计	14,000.00	100.00	14,000.00

3. 项目经济效益评价

本项目的税后内部收益率为 17.74%，税后投资回收期为 5.95 年(含建设期)。

4. 项目用地、立项和环评等事项

本项目计划租用振华科技厂房进行生产建设，建设地点为贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区，不涉及新增土地。截至本次非公开发行股票预案公告日，本项目已完成项目备案，环评批复程序尚在办理中。

（四）继电器及控制组件数智化生产线建设项目

1. 项目概况

项目名称	继电器及控制组件数智化生产线建设项目
项目实施主体	振华群英
建设周期	36 个月
建设地点	贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区
项目建设内容	对生产厂房进行升级改造，新增工艺设备 341 台（套），优化改造生产线线体 10 条，并结合设备需求对动力设施进行新增扩容 2000KVA 配电设施及相关生产辅助动力设施。新增继电器产能 33.08 万只/年、控制组件—智能模块产能 1.80 万只/年、控制组件—配电组件产能 0.12 万只/年。
项目主要产品	继电器、控制组件—智能模块、控制组件—配电组件。
项目投资总额	38,000.00 万元
募集资金投入金额	38,000.00 万元

2. 项目投资概算

本项目投资总计 38,000.00 万元，投资明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	占投资比例（%）	拟投入募集资金
1	建筑工程费	9,971.00	26.24	9,971.00
2	设备购置及安装费	24,660.75	64.90	24,660.75
3	工程建设其他费用	1,305.54	3.44	1,305.54
4	预备费	1,257.81	3.31	1,257.81
5	铺底流动资金	804.90	2.12	804.90
	合计	38,000.00	100.00	38,000.00

3. 项目经济效益评价

本项目的税后内部收益率为 17.65%，税后投资回收期为 6.62 年（含建设期）。

4. 项目用地、立项和环评等事项

本项目计划使用振华群英现有厂房生产建设，建设地点为贵州省贵阳市乌当区中国振华工业园区，项目建设不涉及新增土地。截至本次非公开发行股票预案公告日，本项目已完成项目备案，环评批复程序尚在办理中。

(五) 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目

1. 项目概况

项目名称	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目
项目实施主体	振华华联
建设周期	30 个月
建设地点	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市振华华联厂区
项目建设内容	在振华华联现有厂区内，对已建建筑进行适应性改造并新建厂房。新增一条显控组件柔性生产线，新增八套新型开关柔性自动化生产线，新增一条导光板柔性生产线，新增一条精密行程开关柔性自动化生产线，新增一条电装线，新增工艺设备及系统约 230 台（套）；达到年产机电开关 20 万只、新型开关 10 万只、显控组件 1 万只的生产能力。
项目主要产品	机电开关、新型开关、显控组件
项目投资总额	28,800.00 万元
募集资金投入金额	28,800.00 万元

2. 项目投资概算

本项目投资总计 28,800.00 万元，投资明细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	占投资比例 (%)	拟投入募集资金
1	建筑工程费	4,160.00	14.44	4,160.00
2	设备购置及安装费	20,851.92	72.40	20,851.92
3	工程建设其他费用	607.50	2.11	607.50
4	预备费	896.68	3.11	896.68
5	铺底流动资金	2,283.90	7.93	2,283.90
合计		28,800.00	100.00	28,800.00

3. 项目经济效益评价

本项目的税后内部收益率为 17.54%，税后投资回收期为 6.54 年（含建设期）。

4. 项目用地、立项和环评等事项

本项目建设地点为贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市振华华联厂区，项目建设不涉及新增土地。截至本次非公开发行股票预案公告日，本项目已完成项目

备案，环评批复程序尚在办理中。

（六）补充流动资金

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中 20,000.00 万元用于补充流动资金。

三、本次募投项目实施的必要性

（一）顺应国家政策导向，把握发展机遇

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。当前我国电子元器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题，制约国家航天、航空、核工业、船舶、兵器、电子等战略性新兴产业的发展水平。党的十九届五中全会指出：要努力构建以国内大循环为主、国际国内双循环互动的新发展格局，我国已转向高质量发展阶段，从“数量追赶”转向“质量追赶”，从“规模扩张”转向“结构升级”，从“要素驱动”转向“创新驱动”。党中央国务院在“十四五”规划中提出要加强产业基础能力建设，加快补齐基础零部件及元器件等技术瓶颈短板、提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》中明确到 2023 年，电子元器件销售总额达到 21,000 亿元，突破一批电子元器件关键技术，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位。近年来国家层面的各项产业政策密集落地，为电子元器件行业进一步转型发展提供了有力的政策保障。

振华科技作为国内领先的高可靠电子元器件企业，积极布局电子元器件转型升级，将能切实享受到国家支持政策带来的行业红利，为公司未来的可持续发展提供保障。

（二）满足下游重点工程在高速发展期对高可靠电子元器件的旺盛需求，进一步提升市场占有率

振华科技生产的高可靠电子元器件广泛应用于航空、航天、核工业、船舶、兵器、电子等相关国家重点工程配套领域。下游各行业受惠于“十四五”期间各

项产业扶持计划与政策，尤其航空、航天、核工业、船舶等关乎国家安全的核心工业，整体发展速度与技术迭代的频率都将变得更迅速，对上游高可靠电子元器件产品的需求将大幅度增加。以下游航空行业为例，《中国制造 2025》中明确指出：“预计未来 10 年，我国将需要干线飞机和支线飞机 1940 架”。随着空域管理改革和低空空域开放推进，国内通用飞机、直升飞机和无人机市场也将不断增大。未来随着航空、航天、船舶、汽车电子、5G 通信和工业装备等高新技术产业的进一步发展，其对电子元器件产品的各项技术标准与质量都将提出更高要求，将有力带动高可靠电子元器件产业的快速发展。

本次项目的建设，将有利于公司更好地适应下游客户技术快速迭代引起的对产品性能需求的变化，使公司能够准确匹配下游需求，赢得更多市场份额。

（三）受全球疫情影响，电子元器件供应链安全面临新挑战，国内企业迎来难得发展良机

我国部分高端电子元器件长期依赖进口，高端市场份额被国外厂商占据。近几年，随着新冠疫情的影响在全球范围内不断发酵，各国所采取的严格的交通运输、人口流动等管制措施，不仅影响各个国家的工业生产，对日趋融合的全球产业链、供应链也产生了明显的制约效果。在当前国外电子元器件大厂普遍出现产能不足，供货困难的情况下，国内电子元器件厂商迎来了难得的发展窗口期，振华科技应充分把握当前发展机会，加快产品技术迭代，扩大生产规模，强化市场竞争力，才能进一步巩固技术及市场优势，保障国家重点领域对高可靠电子元器件供应链安全。

（四）扩充现有产能、提升产线智能化制造实力，促进公司高质量发展

振华科技自成立以来，精耕电子元器件研发生产已逾 20 年，公司凭借自身出色的研发设计能力、生产加工工艺、良好的产品质量，赢得了下游一大批需求高可靠电子元器件产品的客户。而随着近年来国家及各部委的有力引导，下游产业蓬勃发展，对上游高可靠电子元器件的需求激增，公司目前多条产线生产能力已趋于饱和。同时，公司目前仍存在部分产线自动化、智能化程度相对偏低，产品批次质量一致性及成品率等方面仍有提升空间，伴随着下游不同客户间对高可

靠电子元器件产品的标准与规格也趋于多样化、复杂化。受制于场地、设备、人员等生产要素，公司当前已不能满足下游客户激增的产品订单及对各自所需产品的定制化需求。

依托本次募集资金投资项目，公司将通过新建产线、对现有产线进行改造等方式实现产能提升，消除当前生产要素对公司发展的制约，提高公司订单承接与供货能力。本次募集资金投资项目还能帮助公司进一步实现产线的智能化、自动化，使公司高可靠电子元器件产品达到更高的质量标准，在提升产品一致性与成品率的同时，降低人工费用，提高公司综合竞争力，促进公司高质量发展。

（五）满足日益增长的流动资金需要，实现可持续发展

近年来，公司业务规模持续增长，进而增加对技术、人才、运营、管理等多方面的资金需求，关键原材料战略性储备有利于维护公司市场地位，降低公司流动性风险。本次非公开发行拟使用募集资金 20,000.00 万元用于补充流动资金，对公司保障供应链安全实现可持续健康发展具有充分的必要性。

四、本次募投项目实施的可行性

（一）国家及各级主管部门相关产业政策的大力支持

近年来，国家级战略规划重点强调核心器件及关键材料实现自主可控，提升高端新型技术与先进工艺的自主研发，摆脱关键电子元器件依赖进口的状况，加速提升国产化水平。电子元器件行业与下游应用领域受到国家政策的大力支持，振华科技各项业务步入高速发展轨道。国家产业政策的大力支持是振华科技本次募投项目能顺利实施的有力保障。

以下为 2021 年以来国家及各部委出台的相关产业政策：

序号	制订单位	政策法规	相关内容
1	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	加强产业基础能力建设，加快补齐基础零部件及元器件等技术瓶颈短板、推动制造业优化升级，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项。
2	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	突破一批电子元器件关键技术，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利

			布局更加完善。形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业。
3	国家发展和改革委员会	《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）	“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”为鼓励类。
4	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》	引导制造业转型升级，到2035年规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化制造。
5	工信部	《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》	提升企业质量管理水平，推动质量控制和质量改进，提升产业链供应链质量协同水平，促进新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业质量品牌提升。
6	国家发展和改革委员会	《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》	聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域产业发展重大任务，结合区域特点制定完善当地发展规划、产业政策以及优化营商环境行动方案，有序承接国内外产业转移。
7	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级，加大财税资金支持，充分利用重大专项资金等机制，落实好税收优惠政策，加强资金支持力度。
8	财政部、国家税务总局	《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》	印发免征进口关税的集成电路生产企业、先进封装测试企业和集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业清单，以及国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用）原材料、配套系统及生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件的免税进口商品清单。
9	中国工程机械工业协会	《工程机械行业“十四五”发展规划》	围绕创新驱动发展战略，加快科技创新，努力实现工程机械产业现代化，全面提升产业基础能力，努力实现工程机械产业高端化，进一步提升工程机械产品质量，强化工程机械产品可

			靠性。
10	中国电子元器件行业协会	《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》	围绕移动智能终端、5G 通信、新能源汽车和智能网联汽车、工业机器人和高档数控机床、轨道交通、航空航天、海洋工程装备和高技术船舶等重点发展领域的电子元器件配套需求，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破，补齐阻碍重点领域发展的重大短板，提高关键电子元器件的配套水平。

（二）高可靠电子元器件市场需求广阔

与振华科技本次募投项目产品相关的各高可靠电子元器件细分领域包括半导体功率器件、混合集成电路、新型阻容元件、继电器及控制组件、开关及显控组件等。受益于我国各项惠及电子元器件行业的政策与规划，各细分领域正在蓬勃发展。以半导体功率器件为例，在“碳中和”、5G 建设等背景下，本就处于需求井喷式增长的半导体功率器件行业陷入供不应求的局面。预计未来中国功率器件市场仍将持续快速增长，2024 年国内市场规模有望达到 206 亿美元。

近年来，国际上单边主义与贸易保护主义抬头。为免受外部环境制约，国务院在《中国制造 2025》国家行动纲领中指出，到 2025 年，70% 的电子核心基础零部件、关键基础材料必须实现自主保障。关键电子元器件供应自主可控、提高国产化率进而降低高端产品长期依赖国外进口已然成为保障我国电子元器件产业链安全的必然选择。

在国家政策的有力支持及自主可控要求下，叠加下游行业对高可靠电子元器件的旺盛需求，振华科技所从事的高可靠电子元器件生产与研发事业将步入高速发展的轨道，广阔的市场前景将为本次项目的顺利实施提供有力支撑。

（三）公司深耕电子元器件产业多年，坚实的技术实力为项目顺利实施提供有效保障

振华科技自成立以来，深耕电子元器件行业已逾 20 年，形成了一揽子成熟可靠、各项技术指标优异的产品集合。近年来，振华科技逐一攻克因技术难度大、工艺复杂而长期依赖进口的高可靠产品，在国产替代、重点工程应用验证方面中

表现优异，有力地支持了航空、航天等高精尖行业自主可控的需求。公司长期承接大量国家科研项目与地方政府产业化项目，其强大的技术攻坚实力与生产配套能力为我国高可靠电子元器件行业突破了一批具有独立自主知识产权、性能达到国际领先水准的国产高端电子元器件产品。公司目前拥有有效授权专利逾 1000 项，在研发投入与专利数量上均处于行业领先地位。

振华科技坚实的技术实力为项目顺利实施提供了有效保障。

（四）先进的质量管理体系为本次募投项目的相关产品提供了可靠的品质保障

高可靠电子元器件产品广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、核工业等对产品可靠性有极高要求的高精尖行业，相比其他高端民用型产品，高可靠型产品多用于具有严酷气候条件、机械条件、辐射条件、电气条件的工作场景，因而对产品极端环境下的有效连续工作性有很高要求。

作为我国高可靠电子元器件领域的领军企业，振华科技始终将其高可靠产品的产品质量放在首要位置，经过多年发展，公司已完善了一套高效合理的质量管理体系，从产品的开发设计源头开始管控品质风险，为产品的顺利量产保驾护航。

先进的质量管理体系是公司产品质量的有效保障，为项目顺利建设提供了有利条件。

（五）优质的客户资源为本次募投项目的顺利实施奠定了市场基础

公司长期向航天、航空、兵器、船舶等领域客户供应高可靠电子元器件，高品质的产品质量与稳定的供货周期一直以来受到客户的广泛好评。公司在各个细分领域长期累积的大量优质客户资源将有利于募投项目产能的快速消化，为本次募投项目的顺利实施奠定坚实的市场基础。

（六）补充流动性资金符合公司实际情况与发展需求

本次非公开发行股票募集资金 20,000.00 万元用于补充流动资金，符合公司所处行业的发展现状及经营资金需求，有利于公司经济效益持续提升和健康发展，有利于增强公司的资本实力，实现公司发展战略。本次非公开发行募集资金用于

补充流动资金切实可行。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家的产业政策及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景与经济效益。本次发行有助于提升公司现有产能和自动化水平，完善公司的产品结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，有利于公司的长远发展，本次非公开发行符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的营运资金与净资产将有所增加，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，有利于降低财务风险、增强经营实力，为公司的持续发展提供保障。本次募投项目的实施并产生效益需要一定时间，短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司的业务规模将有所提升，有利于公司未来营业收入和利润水平的不断增长。

六、本次发行募集资金使用可行性分析结论

综上，本次发行募集资金投资项目符合国家的产业政策及公司的战略发展方向，具有实施的必要性。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景，预计将会为公司带来良好的投资收益，进一步巩固公司的市场地位，有利于公司的长远持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年4月27日